

令和4年度後援会総会の書面開催について

令和4年3月24日

東京薬科大学後援会 会員（保護者）の皆様へ

新型コロナウイルスの感染拡大の防止と感染リスクの回避を踏まえ、令和4年5月に開催する後援会総会は、令和2、3年度と同様に書面開催とさせていただきます。このことについては、後援会会則に基づき、令和3年度理事会（令和4年3月書面開催）で承認をいただきました。

例年5月開催の総会では、500名近い後援会会員（保護者）の方々が参加され、後援会活動の基となる当該年度の事業計画・予算等を審議いただいております。

しかし、本年度も一堂に会して会議を行うことのリスクを考え、書面開催で対応いたしたく、後日総会資料を郵送しますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

東京薬科大学後援会
会長 大場 主雄

本件に関するお問い合わせ

東京薬科大学後援会事務局（学生サポートセンター内）

TEL：042-676-8978（8：45～17：00 平日のみ、土日祝日は除く）

koenjimu-ml@toyaku.ac.jp 〒192-0392 東京都八王子市堀之内 1432-1